（上接A15版）

本公司聘请华泰联合证券、华英证券担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券、华英证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

二十、信息查阅

本报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露，投资者应据此作出投资决策。

本报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

重大风险提示

一、本次交易相关风险

（一）交易终止的风险

1、尽管公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司参与本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为。公司股票停牌前涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》规定的股票异动标准，但公司仍存在因涉嫌内幕交易造成股票异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

2、在本次交易过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被暂停、中止或终止的可能。

3、根据《GP资产收购协议》："截至2019年12月31日或参与本次重组的全体境内投资人和境外投资人同意延期支付全部对价的时间（以较晚时间为准），如果参与本次重组的境内投资人和境外投资人中任一境内投资人和/或任一境外投资人仍未取得上市公司及其关联方应向其支付的LP份额交易全部对价的，建广资产、合肥建广以及智路资本有权单方终止本协议。

在2019年12月31日前1个月内，如参与本次重组的全体境内投资人和全体境外投资人（以下简称"全体参与方"）均书面同意2019年12月31日后仍继续向上市公司及其关联方出售LP份额的或是延长其收款期限的，各方同意，各方应就本次交易和本次重组安排尽其最大商业合理努力与全体参与方进行协商，并在2019年12月31日前确定各方及全体参与方均同意的最终解决方案并签署相关有约束力的文件，否则GP转让方仍有权按照本协议的相关约定终止本协议。"

4、如出现因交易各方对交易方案进行重大调整，可能导致需重新召开上市公司董事会、股东大会审议交易方案的风险或选择终止本次交易的风险。

5、上市公司亦不能排除其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或终止的风险。

（二）融资风险

根据本次交易的实施安排，上市公司在本次交易通过证监会审批后将进行募集配套资金，并通过募集配套资金向境内外GP、境内LP支付部分对价。根据《GP资产收购协议》的约定，如本次重组经中国证监会审核通过，在GP转让方将其依据本协议约定应过户的其所持基金（即同意出售LP份额的境内基金）财产份额过户给小魅科技前且不晚于2019年12月31日（含当日）（两者以较早者为准），小魅科技或其指定的上市公司关联方应向GP转让方合计支付96,333万元人民币，届时由于境内外GP财产份额尚未完成交割，上市公司暂向未启动募集配套资金且用于收购或回购境外LP拥有的全部财产份额的境外并购借款尚未到位（导致合肥中闽金泰借款用于支付境外LP的预付款尚无法偿还），则用于支付GP所持财产份额过户前应支付的96,333万元人民币尚需小魅科技短期对外拆借。

此外，根据上市公司与境外投资人签署的《境外LP资产收购协议》，境内交易完成后，上市公司在境外将通过境外关联方收购或回购境外LP的财产份额，资金来源主要通过境外借款。上市公司及其关联方能否顺利完成上述融资存在一定的不确定性，如果上市公司及其关联方无法及时完成上述融资，可能导致上市公司无法按照约定向相关方支付对价，本次交易进程将被延迟或最终被终止。提请投资者注意本次交易的融资风险。

（三）审批风险

本次交易已经上市公司第九届董事会第三十七次会议、上市公司第九届第三十九次董事会、第九届董事会第四十三次会议审议通过，但本次交易的实施尚需满足多方条件方可完成，包括上市公司股东大会的审批、国家市场监督管理总局反垄断局同意经营者集中的批准、中国证监会的核准以及其他为完成本次交易所必需的由第三方或中国境内外政府机关做出的同意（包括但不限于需要相关金融债权人及担保权人出具的同意函）、批准、授权、登记或备案均已通过当取得且有效。

本次交易已经上市公司第九届董事会第三十七次会议、上市公司第九届第三十九次董事会、第九届董事会第四十三次会议审议通过，但本次交易的实施尚需满足多方条件方可完成，包括上市公司股东大会的审批、国家市场监督管理总局反垄断局同意经营者集中的批准、中国证监会的核准以及其他为完成本次交易所必需的由第三方或中国境内外政府机关做出的同意（包括但不限于需要相关金融债权人及担保权人出具的同意函）、批准、授权、登记或备案均已通过当取得且有效。

本次交易能否获得相关备案、批准、核准或同意，以及最终获得相关备案、批准、核准或同意的时间尚存在较大不确定性，提请投资者注意相关风险。

此外，若本次交易未取得中国证监会的核准，则根据本次交易的有关协议安排，上市公司将采用自筹资金方式向交易对方支付剩余价款，届时将召开董事会、股东大会审议现金购买的重大资产重组方案。若上市公司未能够筹集到足额资金，可能导致上市公司承担违约责任，违约金的有关条款详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（八）违约风险"。

（四）本次交易的政策和法律风险

本公司为中国注册成立的A股上市公司，目标公司为总部注册于荷兰的独立法人实体，且在全球开展经营业务。上市公司不能排除相关政府和监管机构针对本次交易出台政策、法律或展开调查行动，从而延迟本次交易的交割、导致本次交易无法通过审查或导致本次交易终止的风险，提请投资者关注相关风险。

（五）标的资产增值较高的风险

结合上市公司于2018年9月17日发布的重大现金购买草案及2019年3月2日发布的重大现金购买实施报告，上市公司在收购合肥广芯LP财产份额中已出资金额为68.50亿元且通过合肥中闽金泰债务融资支付对价10.15亿元，本次交易拟支付对价为199.25亿元，合计支付267.90亿元，对应合肥裕芯的权益比例合计约为74.46%（穿透计算后），考虑境外JWCapital持有裕成控股的权益份额，对应取得裕成控股的权益合计比例约为79.98%（穿透计算后）。本次交易中，截至2018年12月31日，安世集团100%股权的评估值为338亿元（取整），本次交易的静态市盈率为25.24倍，企业价值倍数（EV/EBITDA）为12.77倍，估值水平较高。此外，本次交易合肥裕芯收购该部分价款原始出资20.82亿美元相比增值较高，增值率为136.54%。提请投资者关注本次目标公司增值较高的风险。

（六）未设置盈利补偿机制的风险

本次交易属于市场化交易，目标公司经营管理团队未持有目标公司的股权，亦不是本次交易的交易对方，根据与交易各方签署的《重组协议》，本次交易未设置盈利补偿机制，未来年度若宏观经济、行业环境出现重大变化、目标公司经营出现重大战略失误等，可能导致目标公司的业绩出现波动，由于未设置盈利补偿机制，上述情况会给上市公司经营业绩带来不利影响，提请投资者关注相关风险。

（七）财务相关风险

根据本次交易的方案，上市公司可能因开购借款、进行约定交等事项，使得财务状况在短期内受到一定不利影响。提请投资者关注如下相关财务风险：

1、因本次交易发生的贷款导致上市公司负债及财务费用上升、现金流紧张的风险

由于本次交易规模较大，上市公司需要通过较多的借款来实现对价的支付。其中，境内收购中（收购合肥裕芯上层的股权），上市公司之全资子公司上海中闽金泰已经取得35亿元人民币的兴业银行并购借款，贷款期限为五年，贷款利率为央行一至五年档期人民币贷款基准利率加2.75%，预计上市公司每年将产生利息费用2.63亿元人民币（暂不考虑本金偿还借款余额下降对利息的影响）；同时上市公司已经取得6.50亿元的股东借款用于增资合肥中闽金泰，根据约定该笔借款的年利率为4.35%，预计上市公司每年将产生利息费用0.28亿元人民币。此外，上市公司在合肥中闽金泰层面向云南省城投借款10.15亿元，借款年利率约定为10%，预计上市公司每年将产生利息费用1.015亿元人民币。境外收购中（直接收购或回购境外LP的财产份额），交易对价拟通过并购贷款的方式来筹集，假设取得约8.235亿美元（若按照人民币兑美元汇率6.8389：1计算，折合56.32亿元人民币）的贷款，目假设境外利率为按照3个月Libor美元利率（2019年2月14日为2.69%）加2.75%，预计上市公司境外关联方每年将承担利息费用约3.06亿元人民币。交易完成后，上市公司上述利息费用合计约为4亿元/年（未考虑并购借款本身的分期还款，且境外贷款实际利率可能高于目前假设），利息费用及贷款本金的偿还会对上市公司盈利能力及财务稳健性产生一定的影响。若在极端情况下，上市公司无法足额募集配套资金或本次交易未能通过中国证监会审核，上市公司为继续履行本次交易各项收购协议的义务预计将新增额外借款，将会带来额外的资金成本，可能会对上市公司持续盈利能力及财务稳健性产生进一步的影响。

2、因本次交易中上市公司将取得小魅科技的控股权，存在若交易终止使得小魅科技需要承担的违约金可能对上市公司财务状况造成不利影响的风险

根据本次交易的相关协议安排，若交易终止（详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（一）交易终止的风险"），小魅科技及上市公司需要承担一定金额的违约金（详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（八）违约风险"），上市公司将承担部分出资损失的风险；若后续上市公司取得小魅科技控股权，将对上市公司财务状况产生较大不利影响。

3、因目标公司银团贷款可能被要求提前偿还对上市公司财务状况产生不利影响的风险

根据目前安世集团所签订的《境外银团贷款协议》约定，若发生担保范围内资产的出售、租赁、转让或其它方式的处置，以及若发生借款人控制权变更，相关贷款安排可能被取消或被要求提前偿还。同时，根据《GP资产收购协议》，如因安世半导体控制权变更导致境外银团依贷款协议要求安世集团或者安世半导体提前偿还境外银行贷款的，小魅科技或其指定的上市公司关联方将负责完成安世半导体境外银团贷款的置换工作，GP转让方将尽其最大商业合理努力配合进行相关工作，如因小魅科技或其指定的上市公司关联方未找到适合的银行贷款替换相关贷款而导致的一切相关责任和不利后果全部由小魅科技自行承担。该事项可能会对上市公司财务状况产生不利影响。

（八）违约风险

由于交易涉及资金金额较大、交易参与方较多、交易环境较为复杂，虽然交易各方均有积极完成交易的意愿以及一定的履约能力，但无法排除各种原因导致上市公司违约或者交易其他方违约的风险。

根据小魅科技与GP转让方签署的《GP资产收购协议》及其补充协议，上市公司拟采用自筹资金方式向交易对方支付剩余价款，届时将召开董事会、股东大会审议现金购买的重大资产重组方案。若上市公司未能够筹集到足额资金，可能导致上市公司承担违约责任，违约金的有关条款详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（八）违约风险"。上市公司将采用自有资金方式向交易对方支付剩余价款，届时将召开董事会、股东大会审议现金购买的重大资产重组方案。若上市公司未能够筹集到足额资金，可能导致上市公司承担违约责任，违约金的有关条款详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（八）违约风险"。

3、因目标公司银团贷款可能被要求提前偿还对上市公司财务状况产生不利影响的风险

根据目前安世集团所签订的《境外银团贷款协议》约定，若发生担保范围内资产的出售、租赁、转让或其它方式的处置，以及若发生借款人控制权变更，相关贷款安排可能被取消或被要求提前偿还。同时，根据《GP资产收购协议》，如因安世半导体控制权变更导致境外银团依贷款协议要求安世集团或者安世半导体提前偿还境外银行贷款的，小魅科技或其指定的上市公司关联方将负责完成安世半导体境外银团贷款的置换工作，GP转让方将尽其最大商业合理努力配合进行相关工作，如因小魅科技或其指定的上市公司关联方未找到适合的银行贷款替换相关贷款而导致的一切相关责任和不利后果全部由小魅科技自行承担。该事项可能会对上市公司财务状况产生不利影响。

（九）商誉减值的风险

本次交易完成后，上市公司将取得小魅科技的控股权，存在若交易终止使得小魅科技需要承担的违约金可能对上市公司财务状况造成不利影响的风险

根据本次交易的相关协议安排，若交易终止（详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（一）交易终止的风险"），小魅科技及上市公司需要承担一定金额的违约金（详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（八）违约风险"），上市公司将承担部分出资损失的风险；若后续上市公司取得小魅科技控股权，将对上市公司财务状况产生较大不利影响。

3、因目标公司银团贷款可能被要求提前偿还对上市公司财务状况产生不利影响的风险

根据目前安世集团所签订的《境外银团贷款协议》约定，若发生担保范围内资产的出售、租赁、转让或其它方式的处置，以及若发生借款人控制权变更，相关贷款安排可能被取消或被要求提前偿还。同时，根据《GP资产收购协议》，如因安世半导体控制权变更导致境外银团依贷款协议要求安世集团或者安世半导体提前偿还境外银行贷款的，小魅科技或其指定的上市公司关联方将负责完成安世半导体境外银团贷款的置换工作，GP转让方将尽其最大商业合理努力配合进行相关工作，如因小魅科技或其指定的上市公司关联方未找到适合的银行贷款替换相关贷款而导致的一切相关责任和不利后果全部由小魅科技自行承担。该事项可能会对上市公司财务状况产生不利影响。

（十）标的资产被质押的风险

根据上市公司与兴业银行上海分行签署的《并购借款合同》，上海中闽金泰持有合肥中闽金泰58.50亿元的注册资本（占合肥中闽金泰的股权比例为45.49%）及本次交易完成后上市公司将持有合肥中闽金泰剩余70.10亿元的注册资本（占合肥中闽金泰的股权比例为54.51%）、合肥中闽金泰持有合肥广芯的全部LP财产份额及合肥广芯持有的合肥裕芯42.94%的股权需向兴业银行质押。截至本报告书签署日，根据合肥市工商行政管理局于2019年1月30日下发的《股权出质设立登记通知书》（合股质登记设字[2019]第611号），上海中闽金泰已将其持有合肥中闽金泰85.250万元的股权质押给兴业银行股份有限公司上海分行。

根据目前安世集团所签订的《境外银团贷款协议》约定，安世集团、安世半导体、安世英国、安世德国及安世美国为《境外银团贷款协议》项下的保证人，并以安世半导体、安世英国、安世德国及安世美国的股权提供质押担保。此外，上市公司在收购境外JW Captial持有的裕成控股股权时拟采用境外银团并购贷款，根据并购贷款的一般要求，贷款主体可能被要求质押其持有的下属公司成资产。

根据上市公司与京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银签订的资产收购协议，若根据监管要求，京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银在募集本次重大资产重组的配套资金前应完成其所持境内基金财产份额的过户，则上述境内基金持有的合肥裕芯股权应在过户前质押给京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银，且上市公司应于办理完毕上述境内基金财产份额过户手续之日起5个工作日内，将上述境内基金财产份额质押给京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银。

提请投资者关注本次交易中标的资产被质押的风险。

（十一）整合风险

本次交易完成后，上市公司将取得安世集团的控制权。后续，上市公司将在认真客观分析双方管理体系差异、尊重安世集团原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，力争做到既能保持各自原有的竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应，从资源整合的角度，在公司治理结构、员工管理、财务管理、企业文化、资源协调运用管理以及业务拓展等方面进行一定的融合。鉴于上市公司与安世集团的业务模式不完全相同，上市公司与安世集团之间能否顺利实现整合具有不确定性。如果整合措施使用不当或整合时间过长，或出现其他因素导致整合过程不顺利，可能影响上市公司的经营与发展，进而会对上市公司的业绩产生不利影响。提请广大投资者注意本次交易整合效果未达预期的相关风险。

（十二）交易完成当年即期回报被摊薄的风险

本次交易实施后，上市公司总资产规模将进一步扩大。从长远角度来看，本次重大资产重组的标的资产将为上市公司带来良好的收益，有助于上市公司业务的提升。根据上市公司公告的2018年业绩快报，2018年上市公司基本每股收益（归母）预计为0.097元/股，根据经审阅的《备考财务报表》，2018年上市公司备考每股收益为0.88元/股，上市公司的每股收益有所提升。

假设上市公司2019年归属于母公司股东的净利润为2017年及2018年的平均值，2020年归母净利润较2019年增长10%，安世集团2019年和2020年的归母净利润均增长10.00%，同时考虑上市公司将为本次收购承担的负债及相应的财务费用（详见本报告书"重大风险提示/一、本次交易相关风险/（七）财务相关风险"）和上市公司总股本的增加，假设本次交易于2019年9月30日完成后，上市公司（安世集团已纳入上市公司合并报表范围）2019年、2020年的基本每股收益分别为0.181元/股、0.896元/股，高于上市公司2018年的实际每股收益。

综上所述，本次交易完成后上市公司的财务状况将会有所提升。但是如果上市公司及标的公司受市场环境变化等因素的影响可能导致盈利不达预期，若市场基准利率上升亦会增加财务费用，可能导致上市公司在短期内每股收益存在一定幅度下滑的风险，可能导致上市公司的即期回报被摊薄。本次交易完成后，上市公司成功取得安世集团的控制权，随着并购借款的偿还以及合并目标公司的盈利，上市公司财务状况、盈利能力有望得以增强。特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。

（十三）商誉减值的风险

本次交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后，上市公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据经审阅的《备考财务报表》，假设本次交易于2018年初完成，上市公司备考合并资产负债表中商誉规模将达到249.63亿元，分别占2018年初上市公司备考合并总资产及净资产的45.15%及158.95%。

对于本次交易完成后形成的商誉，根据《企业会计准则第8号——资产减值》第二十三条规定，上市公司将于每年度终了进行减值测试。本次交易形成的商誉在减值测试中会分摊至相关资产组，这些相关的资产组能够从企业合并的协同效应中受益，收购完成后上市公司与安世集团具有较强的协同效应，如果未来市场环境发生不利变化，上市公司及安世集团业绩不如预期，可能会存在较大的商誉减值的风险，对上市公司的业绩带来重大不利的影响。提请投资者注意上述商誉减值并对上市公司业绩造成不利影响的风险。

二、目标公司及标的公司的经营风险

（一）行业周期性变化的风险

半导体行业具有较强的周期性波动态势，目标公司经营业绩会因为半导体市场的周期性波动而产生一定的影响。半导体行业通常受到终端产品产量变化的影响，而终端产品的产量又与全球经济景气程度高度相关。在较强的经济周期下，目标公司通常为最上终端产品的需求量而扩大产能，但在较弱的经济周期下，较高的固定成本和过量的存货储备会对目标公司的生产经营造成不利影响，从而降低目标公司的毛利率水平。

（二）行业竞争的风险

目标公司目前虽然在半导体行业中具备领先的市场地位，但是其竞争对手同样为世界一流的半导体生产厂商，如安森美半导体（ON Semi）、罗姆株式会社（Rohm）、美国德州仪器公司（TI）、英飞凌（Infineon）等。如果目标公司在产品研发、技术研发、工艺流程等方面未能持续创新或改进，目标公司将无法持续保持竞争优势，从而对公司的盈利能力造成不利影响。

（三）全球化经营的风险

目标公司目前已形成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商。目标公司全球化经营会受到国际政治经济环境变化的影响，包括国际贸易关系、国际政治环境、业务开展国贸易及投资政策、法律法规等。若目标公司管理团队无法持续、准确地判断及应对国际政治经济形势的变化，目标公司的全球经营状况可能受到不利影响。

（四）环境保护的风险

目标公司在生产半导体产品的过程中会涉及废气、废水等污染物的处理和排放，目标公司需要遵守其产品生产所在国家或地区与环境保护相关的法律、法规。目标公司虽然在产品研发设计、生产、销售的全环节中均已执行严格的环保标准，并取得了相关环境认证，同时目标公司已经建立了相应的管理团队确保公司在经营过程中符合环境保护相关的法律法规，但目标公司在生产过程中仍有可能出现违反环境保护相关法律法规的情况，从而面临被相应主管机关处罚的风险，可能会对目标公司的生产经营活动产生不利的影响。

（五）知识产权的风险

半导体行业属于技术密集型行业，该领域涉及众多知识产权。如行业惯例，目标公司在产品开发及生产的过程中，涉及到较多商标、专利、专有技术等知识产权，且存在与其他半导体厂商之间的知识产权授权、被授权或交叉授权等，上述知识产权对目标公司的业务经营至关重要。虽然目标公司已经建立起了多种知识产权保护措施，但是在日常经营中仍然存在一定的自身知识产权被侵犯的风险，如果目标公司无法有效保护自身知识产权，可能对生产经营产生不利影响。同时，目标公司在经营过程中，注重新知识产权的开发以及现有知识产权的改进或提升，但是若目标公司无法持续开发和改进自有知识产权，其竞争实力将受到不利的影响。

（六）核心人员流失的风险

目标公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人员是目标公司生存和发展的重要基础，也是目标公司核心竞争优势之一。目前半导体行业高端技术研发及生产管理人才需求加剧、竞争激烈，如果目标公司不能持续完善各类激励约束机制，可能导致核心人员的流失，使目标公司在技术竞争中处于不利地位，影响目标公司长远发展。

（七）质量控制风险

目标公司产品及生产流程高度复杂，目前拥有较为完善的质量控制体系。但随着目标公司经营规模的持续扩大，质量控制的要求提高，如果目标公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，目标公司产品出现质量问题，将影响目标公司的市场地位和品牌声誉，进而对目标公司经营业绩产生不利影响。

（八）原材料价格等生产成本上升的风险

目标公司产品的主要原材料为硅片、晶圆、化学品等。如果硅片、晶圆、化学品等原材料的价格变化存在较大的波动，会导致目标公司经营业绩出现一定的波动。由于半导体行业的供求变化较快，且上游供应商的集中度较高，在紧缺时期原材料价格可能上行较大。如果目标公司采购的重要原材料价格出现大幅波动，将直接影响其采购成本。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给目标公司的成本控制造成一定压力。

目标公司未来将继续加强原材料采购的管理及优化生产工艺流程，加大工艺升级力度，提高设备利用率；强化节能降耗和材料消耗管理，降低经营成本；提高生产自动化、信息化水平，增强目标公司的盈利能力和抗风险能力。但若目标公司的成本降低战略无法有效实施，未来可能导致目标公司的经营成本出现不断升高。

（九）未来产品毛利率可能出现下降的风险

分立器件、逻辑器件和MOSFET器件被广泛应用在汽车电子、工业控制、消费电子等领域，出货量大，但上述标准产品差异性较小，竞争激烈，下游终端厂商可利用市场影响力、供应商之间的竞争对半导体产品价格施加压力。与此同时，技术的提升和不断标准化的生产工艺有利于大规模制造降低产品成本。

如果未来上述产品价格下降程度超过成本下降的程度，目标公司可能面临产品毛利率下降的风险，将对目标公司盈利能力造成不利影响。

（十）客户流失及客户关系减值的风险

安世集团已形成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商。2017年安世集团收购安世半导体时，安世半导体客户关系经评估存在较大的价值，于2017年末及2018年末安世集团无形资产中客户关系的账面值为1,693,229,017.96元及1,652,200,997.32元，该客户关系将于15年内摊销。虽然下游客户（主要为汽车领域客户）对供应商的严格认证使得安世集团和客户的合作相对稳定，且安世集团拥有全球领先的半导体生产工艺及可靠性评价、丰富的产品组合及规模化的量产能力、覆盖全球的分销体系和销售网络，在客户获取及维护方面具有显著的优势，但安世集团仍然存在产品、技术、服务或价格等不能满足客户的需求，或者因市场环境、竞争对手抢夺市场份额、公司经营等各种因素使得安世集团客户流失或所占客户的供应份额下降，导致客户关系存在减值的风险，对上市公司业绩带来不利的影响。

（十一）外协加工的风险

外协厂商从事的主要生产环节为晶圆代工，封装及测试。报告期内，安世集团的Logic & Protection器件中的Logic器件所需晶圆由代工厂代工；对于封装环节，目前Logic产品线的封装除由安世集团的封测厂封装外，部分由安世集团委托供应商进行封测来补充产能。鉴于晶圆厂投资规模较大，技术更新较快，无晶圆生产模式（fabless）为半导体行业的惯例模式，通常由芯片设计公司提供芯片设计，由晶圆厂（foundry）提供晶圆代工服务。安世集团的双极性晶体管和二极管、MOSFET器件均通过IDM模式生产，Logic产品为Fabless模式生产。安世集团的Logic产品为标准产品系列，晶圆生产工艺相对大规模集成电路的晶圆生产工艺较为简单，集成度相对较低，因此市场中供应商较为充足，不存在对单一供应商的依赖。鉴于安世集团自有的封装测试产能有限，因此安世集团将部分产品线的部分产品委托供应商进行，亦系半导体产业链的惯常分工协作模式。

尽管上述外协加工比例占安世整体产能的比例较低，外协加工模式为半导体行业的惯常分工协作模式，且安世集团及其前身与外协加工厂保持了长期稳定的合作关系，但若上游外协加工厂所处行业出现周期性的产能不足，紧缺等情况，考虑到半导体晶圆制造和封装测试需要较高的协调磨合，可能会导致目标公司无法获得稳定的外协产能或委托加工的费用上升。

（十二）安世中国租赁房屋未取得房产证的风险

安世中国向东莞市集源资产经营管理有限公司（以下简称："集源公司"）、东莞市黄江镇引进公司（以下简称："黄江引进公司"）租赁位于东莞市黄江镇田美工业园北区的两处房屋用于安世东莞工厂的生产和办公，出租方并未就上述租赁房屋取得房产证。根据安世中国出具的说明，安世中国目使用上述租赁房屋均在正常使用，不存在任何政府部门或第三方就其占有和使用租赁房屋提出异议。根据黄江镇人民政府以及出租方出具的证明文件，证明出租方系黄江镇人民政府下属企业，租赁房屋属于出租方目权属清晰，所占土地性质均为工业用地，租赁房屋不存在权属争议，若因租赁房屋权属争议所导致安世中国有关损失的，出租方将依法赔偿安世中国的直接损失。综上，出租方未就上述租赁房屋取得房产证，存在权属瑕疵，虽然出租方已同意若因租赁房屋权属争议所导致安世中国有关损失的，将依法赔偿安世中国的直接损失，但仍然存在安世中国因上述租赁房屋的权属瑕疵而遭受损失的风险。

（十三）未来产能不足或产能扩张受限的风险

安世集团的半导体器件是电子产品各应用领域的基础元器件，广受客户欢迎；随着客户需求的不断增加，安世集团部分产品存在供不应求的情况。随着半导体行业的持续发展，当安世集团的自有产能不足以满足客户需求时，安世集团将通过目建产能、收购产能、寻找其他供应商等方式补足产能不足部分，但是如果安世集团无法取得足够的资金用于目建产能、收购产能或无法及时寻找到合适的供应商，则有可能导致安世集团的产能不足。此外，由于晶圆制造环节新建产能的投资金额较大，而本次交易完成后安世集团的并购贷款亦较高，预计安世集团的债务融资能力有限，则安世集团目建产能主要依赖经营所得现金，目建产能或收购产能的产能扩张受限。

（十四）目标公司可辨认资产评估增值对未来利润摊薄的风险

根据中联评估出具的中联评报字[2019]第168号评估报告，目标公司安世集团于2018年12月31日的无形资产、固定资产及存货等出现评估增值。预计本次交易的交割日安世集团仍然会存在上述资产的评估增值，由于本次交易属于非同一控制下的重组，收购完成后，安世集团将纳入上市公司合并范围，上述资产于交割日的评估增值部分将于一定期限内在上市公司合并报表中进行折旧及摊销，会摊薄上市公司未来的利润，提请投资者注意上述资产评估增值并对上市公司未来业绩造成不利影响的风险。

三、其他风险

（一）股票市场风险

股票市场投资收益与投资风险并存。公司股票价格的波动不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期及重大突发事件等多种不可预知因素的影响。上市公司一直严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，加强与投资者的沟通，同时采取积极措施，尽可能地降低股东的投资风险。但是，本次重组仍然需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（二）其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第一章本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、抓住国家战略发展机遇，推进半导体行业发展

半导体行业是信息技术产业的基础和核心产业之一，被誉为国家工业的"明珠"，是信息产业的"心脏"。半导体行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展和产业升级上具备战略性作用。我国政府高度重视集成电路产业的发展，相继出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》、《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》等政策文件，设立了国家科技重大专项，指导制定了《集成电路产业"十二五"发展规划》等，并于2014年设立了国家集成电路产业投资基金，从政策、资金、市场等多个方面推动国内集成电路产业发展环境持续优化。在国家政策和市场环境的支持下，借助国内旺盛的半导体需求，近年来我国半导体产业快速发展，整体实力显著提升，根据中国半导体行业协会的数据显示，我国半导体行业2017年销售规模达5,411.3亿元，2015年至2017年行业销售规模增速为19.71%、20.10%和24.81%，行业增速明显高于全球水平。国家政策的大力推动是近年来半导体行业迅猛发展的重要驱动因素之一，在中国经济结构调整升级过程中，国家政策将持续利好半导体行业。

2、汽车电子化大势所趋，拉动半导体行业高速增长

随着AI技术、移动互联网技术以及电子技术的发展，相关新技术已经逐步开始在汽车领域渗透，智能化、电子化以及联网化将成为未来汽车行业的发展方向，传统汽车电子领域将迎来新一轮技术升级换代，电系统、整车控制、驱动系统、储能系统等子系统都将迎来新的产业升级机遇。

随着汽车电子产业的成熟以及整车销售的竞争日趋激烈，汽车电子呈现持续向低端车型渗透的行业特点。很多汽车电子产品已经从高端车型的专利成为普通车型的标配。高端汽车电子系统进一步向中低端汽车渗透是必然趋势，而这一趋势将会进一步提高单车电子系统种类及成本。相比于高端车，中低端车保有量更大，市场空间也更为广阔。高端电子系统低端渗透的产业趋势将极大提振汽车电子市场，带来量价双重实质性提高。

全球汽车电子市场处于成长阶段，2017 年全球汽车电子市场规模达到 2,300亿美元，同比增长 6.98%，预计 2019 年增长至 2,800 亿美元。2017 年我国汽车电子市场的营业收入规模为 796 亿美元，同比增长 9.96%，预计 2019 年将达到 962 亿美元。随着电动汽车产销的增长以及汽车电子化趋势的进一步扩大，涉及动力控制和安全控制类的应用市场迎来扩容机遇；而中国汽车电子的渗透率仍然低于先进国家水平，未来发展空间较大。预计在汽车电子化的发展进程中，将为半导体市场发展进一步提速。

3、车联网、物联网、5G 等国家战略和新兴行业带来新的业务发展机会

2013年之前，以PC为代表的计算机是半导体最大的应用市场，2013年至今，以智能手机为代表的通讯设备取代计算机成为半导体产业支柱，是半导体市场发展的最重要驱动力。物联网应用范围广大、数量巨大，市场规模庞大，将会是半导体市场的下一个增长点，包括了汽车电子、智能家居、智能穿戴等领域。

伴随物联网及5G商用拓展，人工智能也将是未来半导体发展的重要动力之一。新兴领域对半导体产品的需求不断涌现。5G的商用化将推动物联网大爆发，据国际调研机构Yole预测，到2020年全球物联网设备数量将达到260亿个，物联网市场规模达1.9万亿美元。物联网的发展将极大地刺激车联网、智能家居、AR/VR、人工智能（AI）等智能硬件领域的发展，通信基础设施及其他终端智能硬件产业将全面升级。未来5-10年是物联网的快速增长期，也是全球智能硬件发展的黄金时间。

4、全球半导体领域并购风起云涌，行业整合不断加快

根据国际调研机构IC insights报道，2017年世界半导体产业并购交易总值为277亿美元，相比2016年的并购交易额明显下滑，但与2010-2014年平均交易额约为126亿美元相较，仍是有两倍有余。2017年各国政府对半导体领域的并购审查趋严，尽管如此，全球范围内半导体产业整合仍日保持活跃，大型并购交易不断涌现，例如私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）领衔的财团以180亿美元收购日本东芝半导体（ToShiba）存储芯片业务的49%股权；迈威尔（Marvell）以60亿美元收购网络通信设备Cavium公司。此外，上述IC insights统计不包括英特尔（Intel）以153亿美元收购以色列智能视觉公司Mobileye（2018年已终止），博通（Broadcom）在2017年年底以1,030亿美元高价要约收购高通（Qualcomm）（2018年已终止）和2017年高通调整交易额至380亿美元启收购恩智浦（NXP）并导致各国的反垄断调查（2018年已终止），半导体领域主要厂商通过并购的方式进入新兴领域，拓展业务领域，挖掘潜在协同效应，行业整合速度不断加快。

5、国产半导体人才储备不足的风险

半导体产业属于资本人才密集型产业，国际半导体巨头公司每年在半导体研发及工艺技术上的投入金额巨大，但是半导体产业回报周期长、技术壁垒高、对人才的依赖度大，这些都决定了整个半导体产业需要长期积累，难以短期内快速发展。

虽然我国半导体产业已经取得长足进步，但是产业中仍然存在持续创新能力薄弱、制造工艺落后、产业发展与市场需求脱节等突出问题，产业发展水平与先进国家和地区相比依然存在较大差距。在高端半导体产品领域，对进口依赖程度仍旧较高，难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有力支撑，因此我国半导体产业发展正面临巨大的挑战。尽管如此，我国半导体行业经过较长时期的积累和持续资本投入，已经在部分领域取得突破，产业升级加速。国内公司通过并购海外优质半导体资产的方式可以快速获得境外龙头半导体公司的核心技术和工艺技能，通过并购整合、产业落地、需求引导等方式进行技术吸收，在已有技术的基础上不断创新和超越，最终实现核心半导体技术的自主可控，获得全球竞争优势。

（二）本次交易的目的

1、本次交易是上市公司把握重大产业投资机遇的战略举措

为把握国内半导体行业的发展机遇、提升我国在标准器件半导体领域的实力，上市公司作出了本次收购安世集团的决策，并为取得其控制权进行了充分周密的事前准备。本次交易前，上市公司下属的合肥中闽金泰龙头企业已经进行了公开竞拍并被确定为受让方。2019年2月28日，前次重大现金购买交易已完成，合肥中闽金泰持有合肥广芯493,664,630659万元财产份额，成为合肥裕芯的单一最大出资人。本次交易完成后，上市公司将取得安世集团的控制权，从而增强上市公司的产业整合能力，考虑到安世集团与上市公司均为国内外知名的公司，且具有较强的协同效应，本次交易将会为上市公司可持续发展提供坚实保障。综上，本次交易是上市公司把握重大产业投资机遇的战略举措。

2、本次交易有利于补足我国在标准器件半导体领域的短板

本次交易的目标公司安世集团为半导体标准器件供应商，集设计、制造、封装测试于一体，其产品广泛应用于汽车、工业控制、计算机、消费电子等领域。安世集团拥有60多年的半导体行业业绩验，其分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的市场占有率均处于全球前三名的位置。安世集团下属主要经营实体经过多年的发展和积累，在复杂电磁、温湿度等极端环境下能保持极高的一致性和有效性；同时，生产工艺成熟、封测技术领先、规模化量产能力较强，具备多领域多产品线的稳定供货能力，年产销超过900亿件。相较之下，国内半导体厂商在上述产品领域还存在较大差距，本次交易完成后，上市公司将会取得目标公司的控制权，弥补国内企业在上述产品领域的短板。半导体产业技术壁垒高、核心环节被外资主导，在欧美等国日趋严厉的交易审查甚至收购排斥的背景下，国内企业通过并购国外优质半导体公司实现赶超难以再现，国内企业成功收购安世集团显得极为珍贵。通过本次交易，上市公司将间接取得安世集团的控制权，上市公司的产业化背景能够有力推进安世集团的产业发展。

3、上市公司和安世集团处于行业上下游，在技术、客户和产品上具有协同效应

闻泰科技处于产业链